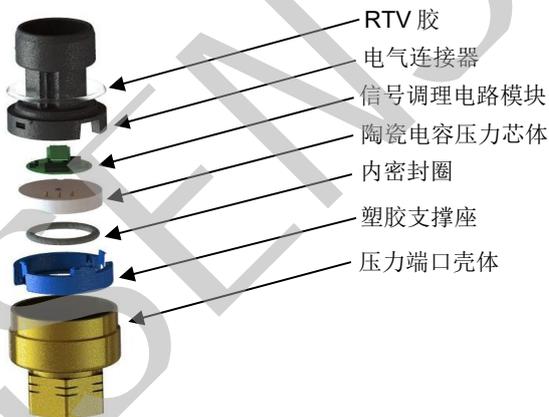




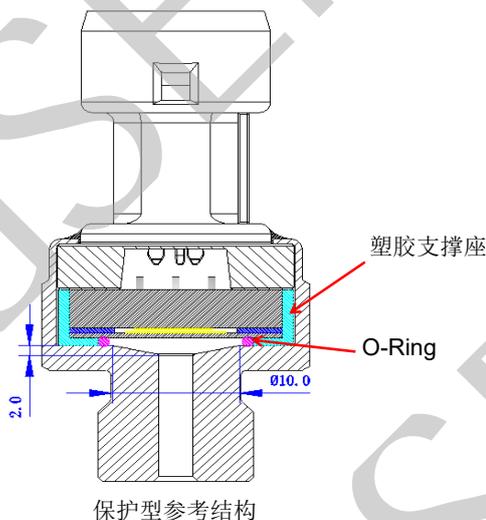
产品封装参考

1.1 产品典型应用结构



组成部件	作用
RTV胶	防水防尘
电气连接器	与 ECU 进行电气连接
信号调理电路模块	将电容变化信号转换成电压信号
圆形陶瓷电容压力芯体	将流体或气体压力转换成电容量
内密封圈	压力密封及防止液体泄漏
塑胶支撑座	保护芯体&模块化
压力端口壳体	与流体系统机械连接

2.1 传感器封装结构设计参考



封装建议点:

- 尽量采用保护型设计，避免芯体承受过大铆压应力；
- 建议适当减少陶瓷电容芯体敏感区与金属壳体轴向视角重叠的面积，或适当增加电容敏感区与金属壳体的距离，以减小两者相对位置变化而影响输出波动；
- 避免硬接触，建议塑料垫圈最外圈适当避让，以避免陶瓷压力芯体边缘受力破损。

联系人: 谢先生

联系电话: +086-15920384518

地址: 广东省东莞市常平镇环常北路 568 号常平珠宝文化产业园 27 栋